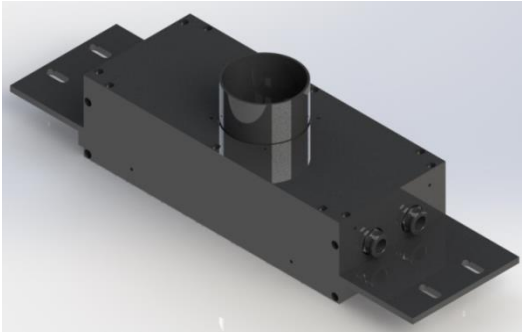


고효율 USC 파티클 제거기

USC-TS 시리즈 [TS200, TS300, TS400]

PSM USC-TS 시리즈는 생산공정 중 기판상에 발생하는 수 마이크론 크기의 미세 파티클을 효과적으로 제거 할 수 있는 고효율의 파티클 제거 장치 임



주요 특징

1. Mechanical Double Ultrasonic Air Flow 와 Triple Suction 구조를 가지고 있어서 다양한 크기의 (1~100 μm) 파티클 제거에 효율적이며 타사대비 동등 수준 이상의 제거 성능을 가짐

2. 상대적으로 Compact 한 모듈 크기로 설치가 용이하고 유지보수가 간단 함

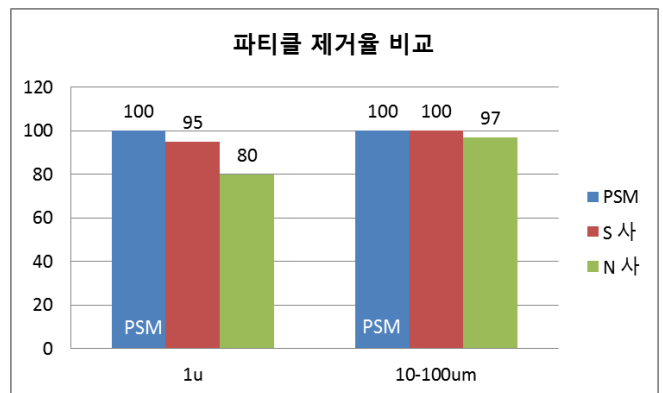
주요 적용분야

USC-TS 시리즈는 TSP 모듈공정과 Cover Glass 코팅 전처리 용으로 미세 파티클 제거 공정에 사용됨

- TP 라미네이션 OCA/OCR 전처리, Pol Film 부착 전 처리
- Cover Glass AF 코팅공정 전처리
- FPCB, BLU 등 경량 기판 공정 전처리

제품 주요 성능

- 파티클 제거 효과 비교



- 최대 처리속도 ~ 500 mm/sec
- 처리 Gap 3mm~15 mm
- 토출 공기압력 0.14 Mpa
- Ionizer 모듈 (Option)
- 경량샘플 처리용 Stage (Option)

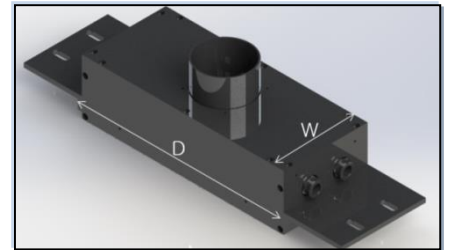


TECHNO

Dimension of USC-TS Module

▶ USC-TS

MODEL	Cleaning Area	W[mm]	D[mm]	H[mm]	Dust Collector
USC-TS100	100	100	140	107	LC-50
USC-TS200	200	100	240	107	LC-100
USC-TS300	300	100	340	107	LC-100
USC-TS400	400	100	440	107	LC-200
USC-TS500	500	100	540	107	LC-200
USC-TS600	600	100	640	107	LC-200



▶ 집진기 모듈 (Dust Collector Module)

MODEL	풍량 [CMM]	정압 [mmAq]	출력 [kW]	W[mm]	D[mm]	H[mm]
LC-50	7	210	0.55	512.5	522	773
LC-100	12	230	0.75	740	692	1013
LC-200	30	230	1.5	740	692	1298

